



EV GROUP GEWINNT 3D INCITES "PROCESS OF THE YEAR" AWARD FÜR NANOCLEAVE LAYER RELEASE TECHNOLOGIE, WELCHE DIE 3D INTEGRATION REVOLUTIONIERT.

Prestigeträchtige Branchenauszeichnung für eine Technologie, die einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Roadmap für die heterogene Integration liefert

ST. FLORIAN AM INN, ÖSTERREICH, 14. März 2023—EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine NanoCleave™-Infrarot-(IR)-Laser-Cleave-Technologie den renommierten 3D InCites Award 2023 in der Kategorie "Process of the Year" erhalten hat. NanoCleave ermöglicht den nanometergenauen Layer-Transfer durch Silizium, wodurch Glassubstrate für Advanced Packaging überflüssig werden und die 3D-Stapelung dünnster Schichten für die Front-End-Verarbeitung, einschließlich fortschrittlicher Logik-, Speicher- und Leistungsbaulemente, ermöglicht wird.

Die 3D InCites Awards werden von [3D InCites](#), einer 2009 gegründeten Online-Community-Plattform zur Förderung des Interesses an der 3D-Integration, vergeben. Sie zeichnen bedeutende Beiträge zur Weiterentwicklung der Roadmap für die heterogene Integration aus, darunter 3D-Packaging, Interposer-Integration, fortschrittliches Fan-out-Packaging auf Waferebene, MEMS und Sensoren, Chiplets und vollständige Systemintegration. Die diesjährigen Auszeichnungen wurden heute im Rahmen einer Zeremonie auf der IMAPS Device Packaging Conference in Fountain Hills, Arizona, verliehen.

"Es liegt nahe, EV Group zum 10. Jahrestag der 3D InCites Awards mit dem vierten 3D InCites Award auszuzeichnen, da sie ihren ersten Preis in der Kategorie Anlagen bei unserer Eröffnungsveranstaltung im Jahr 2013 erhielten", sagte Françoise von Trapp, Gründerin von 3D InCites. "Wir gratulieren dem Unternehmen zu seinem unermüdlichen Streben nach Höchstleistungen bei heterogenen Integrationsprozessen und -technologien."

EVG bietet seit mehr als 20 Jahren Lösungen für fortschrittliches Packaging und heterogene Integration an und unterstützt revolutionäre technologische Fortschritte wie rückseitig belichtete CMOS-Bildsensoren (BSI-CIS), 3D/Stacked Die Packaging, ultradünne und gestapelte Fan-out-Packages und Silizium-Photonik. Die branchenführenden Produkte des Unternehmens für Wafer-Level und Die-Level Fusion- und Hybrid-Bonding, Dünnwafer-Handling und Lithographie werden durch das [Heterogeneous Integration Competence Center™](#) von EVG unterstützt, das darauf ausgelegt ist, Kunden bei der Nutzung der Prozesslösungen und des Fachwissens von EVG zu unterstützen, um neue und verbesserte Produkte und Anwendungen zu ermöglichen, die von Fortschritten in der Systemintegration und im Packaging angetrieben werden.

NanoCleave, die jüngste Entwicklung von EVG im Bereich der heterogenen Integration, nutzt einen IR-Laser und anorganische Materialien, um das Laser-Debonding auf Silizium mit Nanometer-Genauigkeit zu ermöglichen. Dies macht Glassubstrate für fortschrittliches Packaging überflüssig, vermeidet Probleme mit der Temperatur und der Kompatibilität von Glaträgern und ermöglicht die Übertragung ultradünner Schichten (ein Mikrometer und darunter) über Carrier in der Front-End-Verarbeitung, ohne die bestehenden Prozesse zu verändern. Die Präzision im Nanometer-Bereich des neuen EVG-Prozesses unterstützt die Roadmaps für moderne Halbleiterbaulemente, die dünnere Schichten und Packages, eine zunehmende heterogene Integration und geringere Verarbeitungskosten durch den Transfer dünner Schichten und den Verzicht auf Glassubstrate fordern.

-mehr-



"Im Namen von EV Group möchte ich der Jury und den Lesern von 3DInCites unseren aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass sie NanoCleave™ als den diesjährigen 3D-InCites-Prozess des Jahres ausgezeichnet haben", sagte Paul Lindner, Executive Technology Director bei EV Group. "Unser Team hat sehr hart an der Entwicklung dieser revolutionären IR-Lasertrenntechnologie gearbeitet, und wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Roadmaps für fortschrittliche Devices und Packaging mit Hilfe von NanoCleave zu realisieren. Wir glauben, dass NanoCleave ein echter Wegbereiter für die 3D- und heterogene Integration sowie den Materialtransfer in der nächsten Generation skalierten Transistordesigns ist, und es ist eine Ehre, dass es von der Industrie als solches anerkannt wird."

Für weiterführende Informationen zu EVG's NanoCleave IR-Laser-Cleave-Technologie besuchen Sie <https://www.evgroup.com/technologies/nanocleave/>.

Über EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 1250 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Mehr Informationen unter www.EVGroup.com.

Kontakte:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-mail: dmoreno@openskypr.com

###